

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年9月23日(23.09.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/187235 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/36 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
H01L 23/29 (2006.01) C08L 63/00 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/009269

(22) 国際出願日: 2021年3月9日(09.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-045532 2020年3月16日(16.03.2020) JP
特願 2020-045533 2020年3月16日(16.03.2020) JP

(71) 出願人: 三菱ケミカル株式会社
(MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1008251 東京都千代田区丸の内
一丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 太田 員正(OTA, Kazumasa); 〒1008251
東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 三
菱ケミカル株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 重野 剛, 外(SHIGENO, Tsuyoshi et al.);
〒1600022 東京都新宿区新宿二丁目5番1
0号日伸ビル9階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,

BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

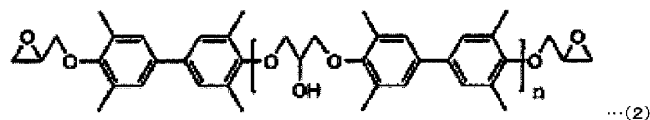
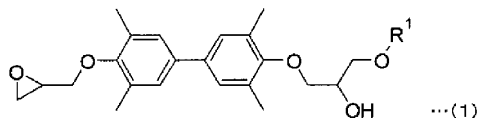
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: EPOXY RESIN COMPOSITION, CURED PRODUCT AND ELECTRICAL/ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: エポキシ樹脂組成物、硬化物及び電気・電子部品



(57) Abstract: An epoxy resin composition (A) containing an epoxy resin represented by formula (1) and an epoxy resin represented by formula (2). An epoxy resin composition (B) containing 0.01-1000 weight parts of a curing agent per 100 weight parts of this epoxy resin composition (A). (R^1 is a C1-6 linear aliphatic hydrocarbon group) (n is an integer of 0 or 1)

(57) 要約: 下記式(1)で表されるエポキシ樹脂及び下記式(2)で表されるエポキシ樹脂を含むエポキシ樹脂組成物(A)。このエポキシ樹脂組成物(A)100重量部に対し、硬化剤を0.01~1000重量部含むエポキシ樹脂組成物(B)。(R¹は炭素数1~6の直鎖の脂肪族炭化水素基)(nは0~1の整数)



WO 2021/187235 A1